



各 位

2026 年 2 月 3 日

上 場 会 社 名	イ ビ デ ン 株 式 会 社
代表者の役職氏名	代 表 取 締 役 社 長 河 島 浩 二
( コ ー ド 番 号	4062 東証プライム、名証プレミア)
責任者の役職氏名	経営企画本部 財務部長 西村 克俊
電 話 番 号	(0584)81-3111

## 高機能 IC パッケージ基板向け設備投資(固定資産の取得)に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、昨年 5 月に開示した 2030 年度目標の達成に向け、2026 年度から 2028 年度の 3 ヶ年で電子事業への、総額約 5,000 億円規模の投資計画を決議いたしました。その最初のフェーズとして、高性能サーバー向けを中心とした、高機能 IC パッケージ基板の生産能力増強を図る目的で、既設の河間事業場工場棟 (Cell6) を中心に、追加の設備投資を実施することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 設備投資計画の全体構想

1. 目 的：高機能 IC パッケージ基板 (AI サーバー、及び高性能サーバー向け) の生産能力増強
2. 想定期間：2026 年度から 2028 年度 (3 ヶ年)
3. 投資総額：約 5,000 億円
4. 対 象：①河間事業場 (岐阜県大垣市河間町 3-200) 及びその他海外を含む既存工場  
②大野事業場 (同揖斐郡大野町下磯 237-1) 及びその他海外を含む既存工場
5. 具体的な設備投資計画：  
＜場 所＞ 河間事業場及びその他海外を含む既存工場  
＜投 資 額＞ 約 2,200 億円 (予定)  
＜稼働時期＞ 2027 年度より順次稼働し、量産開始の計画  
＜生産能力＞ 本件投資により、2027 年度以降の高機能 IC パッケージ基板需要に対応可能な  
生産能力の増強を実施

#### 2. 今後の見通し

本投資による当期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上